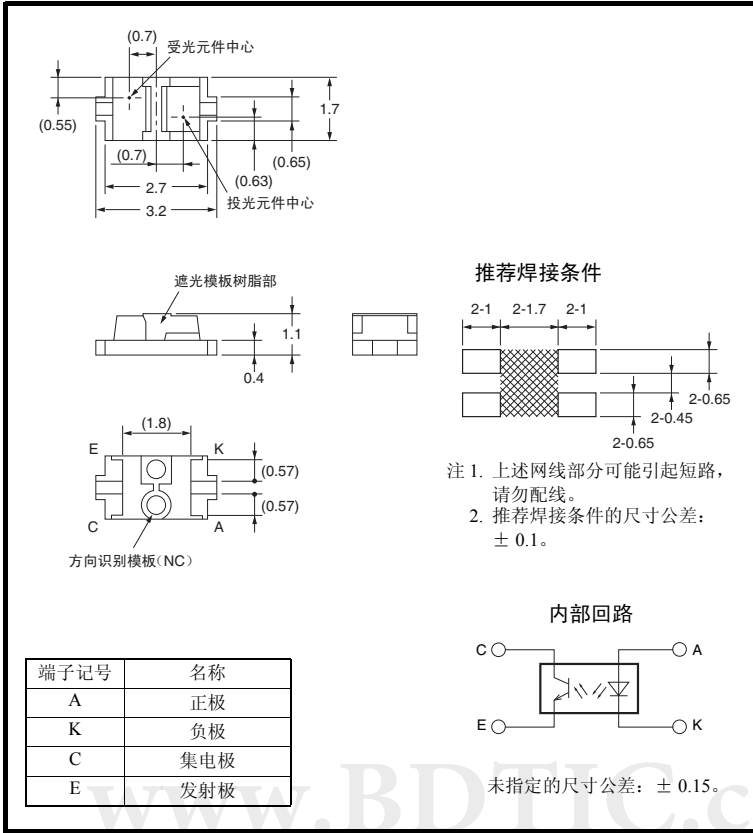


### 外形尺寸

(单位: mm)



### 特征

- 超小型传感器
- 印刷线路板表面实装型

### 绝对最大额定值 (Ta = 25°C)

项目	记号	额定值	单位
发光侧	正向电流	I <sub>F</sub>	50 *1 mA
	反向电压	V <sub>R</sub>	6 V
受光侧	集电极发射极之间的电压	V <sub>CEO</sub>	35 V
	发射极集电极之间的电压	V <sub>ECO</sub>	6 V
	集电极电流	I <sub>C</sub>	20 mA
	集电极损耗	P <sub>C</sub>	75 *1 mW
容许损耗总量	P <sub>tot</sub>	100 *1 mW	
动作温度	T <sub>opr</sub>	-25 ~ +85	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	-40 ~ +100	°C
焊接温度	T <sub>sol</sub>	260 *2	°C

\*1 环境温度超过 25 °C 时, 请参阅温度额定值图。

\*2 焊接时间请控制在 5 秒以内。

回流焊接时, 请按第 4 页记述的条件进行焊接。

### 电气及光学特性 (Ta = 25°C)

项目	记号	特性值			单位	条件	
		MIN.	TYP.	MAX.			
发光侧	正向电压	V <sub>F</sub>	—	1.2	1.4	V	I <sub>F</sub> = 20mA
	反向电流	I <sub>R</sub>	—	—	10	μA	V <sub>R</sub> = 6V
	最大发光波长	λ <sub>P</sub>	—	950	—	nm	—
受光侧	光电流	I <sub>L</sub>	40	85	130	μA	I <sub>F</sub> = 4mA, V <sub>CE</sub> = 2V 铝蒸镀膜玻璃, d = 1mm*
	暗电流	I <sub>D</sub>	—	1	100	nA	V <sub>CE</sub> = 20V, 0 lx
	泄漏电流	I <sub>LEAK</sub>	—	—	500	nA	I <sub>F</sub> = 4mA, V <sub>CE</sub> = 2V 无反射状态
	集电极发射极之间的饱和电压	V <sub>CE(sat)</sub>	—	—	—	V	—
	最大光谱灵敏度波长	λ <sub>P</sub>	—	930	—	nm	—
上升时间	t <sub>r</sub>	—	20	100	μs	V <sub>CC</sub> = 2V, R <sub>L</sub> = 1kΩ I <sub>L</sub> = 100μA, d = 1mm*	
下降时间	t <sub>f</sub>	—	20	100	μs	V <sub>CC</sub> = 2V, R <sub>L</sub> = 1kΩ I <sub>L</sub> = 100μA, d = 1mm*	

\* 请参阅第 2 页「图 12. 光电流测定配置图」

■ 额定值・特性曲线

图 1. 正向电流・容许损耗的温度额定值图

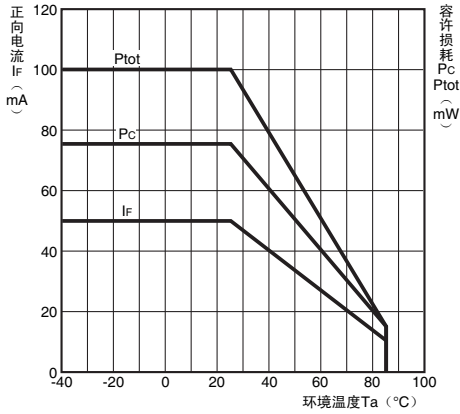


图 4. 光电流-集电极发射极之间的电压特性 (TYP.)

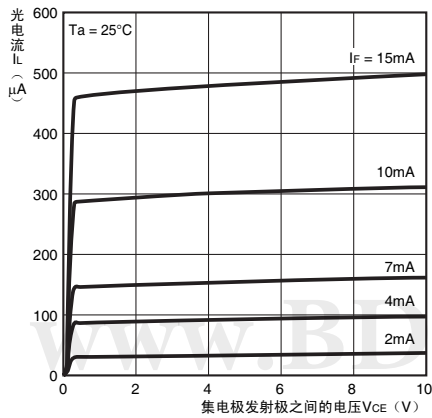


图 7. 应答时间-负载电阻特性 (TYP.)

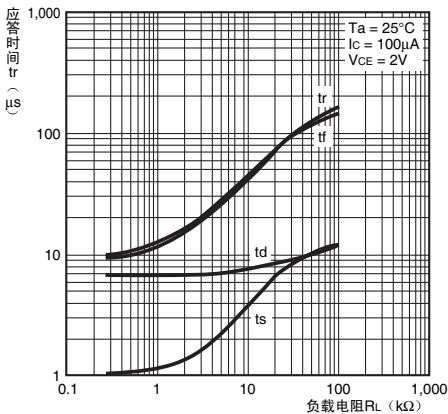


图 10. 相对光电流-卡片移动距离特性 (TYP.)

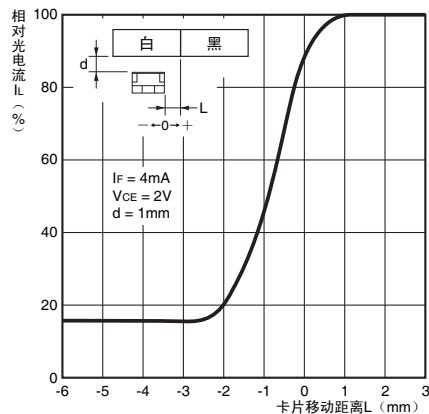


图 2. 正向电流-正向电压特性 (TYP.)

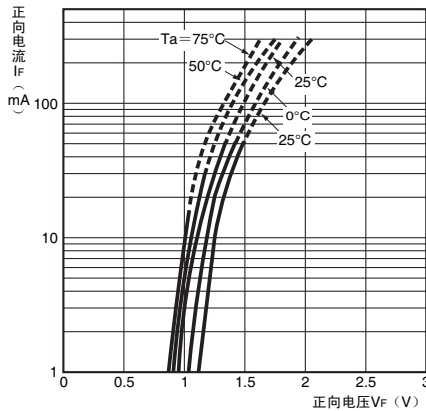


图 5. 相对光电流-环境温度特性 (TYP.)

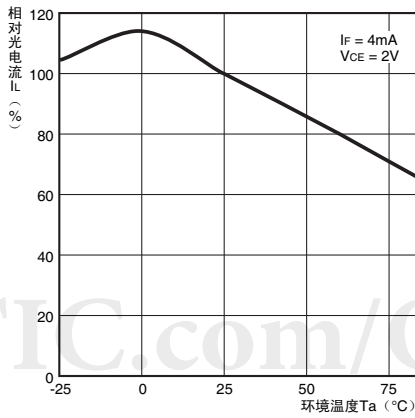


图 8. 相对光电流-距离特性 (TYP.)

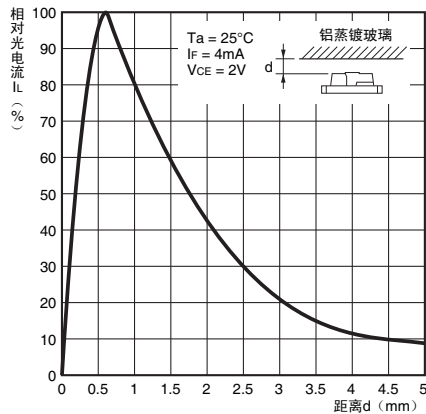


图 11. 应答时间测定回路

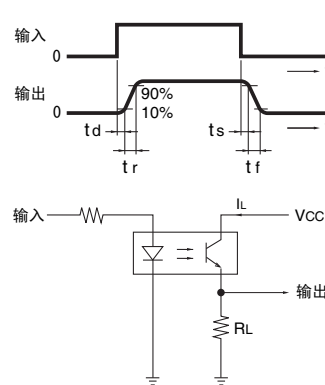


图 3. 光电流-正向电流特性 (TYP.)

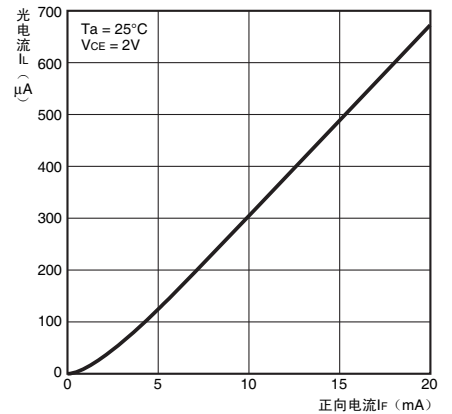


图 6. 暗电流-环境温度特性 (TYP.)

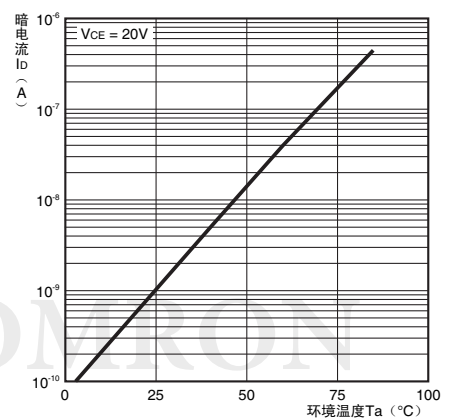


图 9. 相对光电流-卡片移动距离特性 (TYP.)

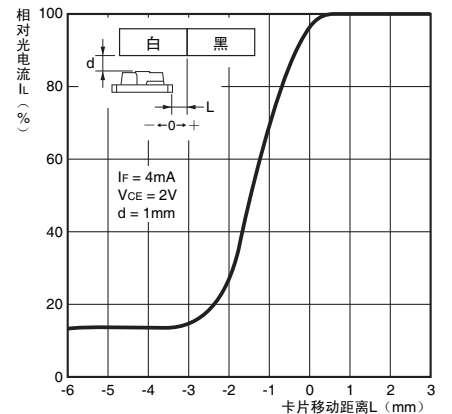
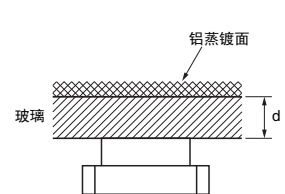
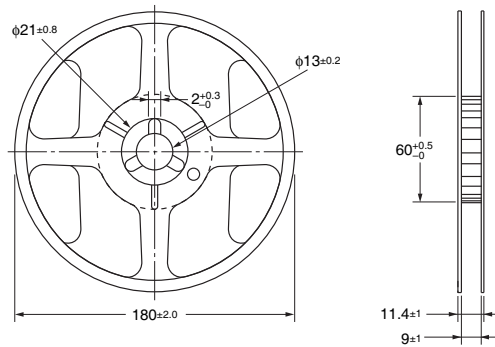


图 12. 光电流测定配置图

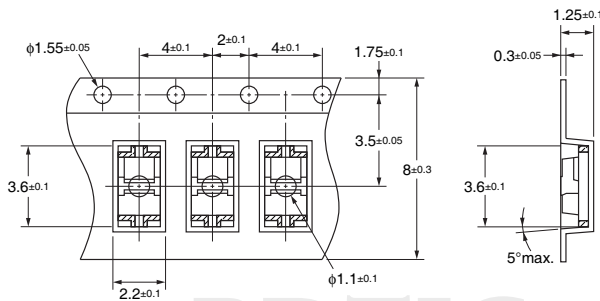


## ■ 编带规格

### ● 卷轴形状尺寸 (单位: mm)

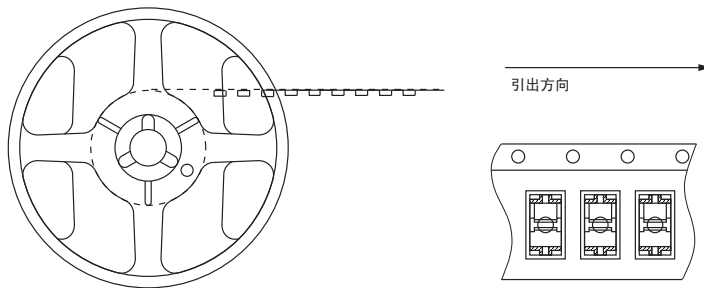


### ● 编带尺寸 (单位: mm)



### ● 部件装入方向

- 将设备置于载带的方孔时，其发光二极管的侧面需面向输送口的圆孔。



### ● 数量

2,000 个 / 卷

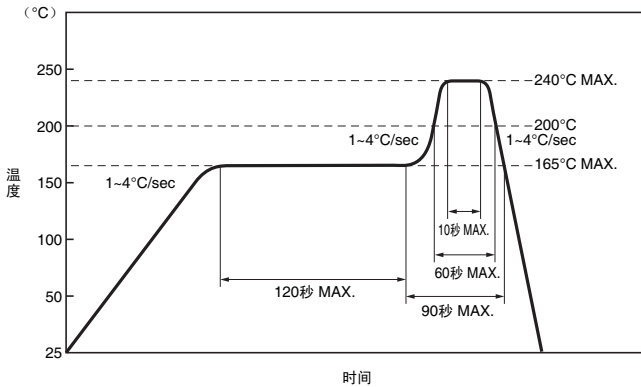
### ● 包装规格

- 铝袋由一个编带卷轴密封。
- 标签上记载有「型号」、「批号」、「数量」。

## ■ 实装注意事项

### ● 温度曲线

请在低于下图温度曲线的温度及时间条件下操作一次。



### ● 关于焊锡量

若锡焊展开至产品外壳与线路板上的端子配线模板处，可能降低产品牢靠性，设定焊锡量时，请保证其范围不超出产品端子的侧面。

### ● 其他注意事项

焊接时若用红外灯加热，可能导致树脂部分的局部温度上升。

使用时，请保证外壳温度在温度曲线范围之内。

此外，请勿使树脂部分与锡焊接触。

即便温度符合上述范围，但若线路板弯曲、凹凸对端子造成应力时，可能导致外壳内部的金线断裂，请在确认工程条件无误后，再将其用于贵公司的回流装置。

## ■ 保存及开封后的处理

### ● 保存条件

请在下列条件下保存。

温度：5 ~ 30 °C

湿度：70%RH 以下

### ● 开封后的处理

请于开封后两日内，在温度 5 ~ 25 °C、湿度小于 60% 的条件下完成实装。

若开封后需长时间保存，请用干燥箱储存，或加入干燥剂、再用市场上出售的密封条等密封后保存于防潮包装内，并且，保存条件需满足温度 5 ~ 30 °C，湿度 70%RH 以下，并于两周之内完成实装。

### ● 安装前的烘烤（干燥）处理

若无法实现上述处理，可采取烘烤处理，再进行实装。但是，烘烤处理只能进行一次。

推荐条件：125 °C、16 ~ 24 小时

※进行烘烤处理时，请将产品包装打开，否则无法处理。烘烤时，请将产品预装于线路板上，或放于金属盘上。

### ● 清洁条件

溶剂浸泡清洁：

溶剂温度：45 °C 以下

浸泡时间：3 分钟以内

超声波清洁：

请勿用超声波清洁。

推荐溶剂：

乙醇、甲醇、异丙醇